

EPBOARD 0700HT

Epoksydowa płyta modelarska

ZASTOSOWANIA

EPBOARD 0700HT to odporna na wysoką temperaturę epoksydowa płyta modelarska, odpowiednia do modeli wzorcowych w produkcji autoklawowych form prepregowych. Może być również używana do formowania próżniowego lub bezpośrednio na formy do małych serii części kompozytowych.

CECHY

- Wysoka stabilność wymiarowa
- Dobra odporność na pękanie, doskonała stabilność krawędzi
- Wysoka odporność cieplna
- Mała gęstość
- Wysoka jakość powierzchni

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Produkt	EPBOARD0700HT
Kolor	Ciemnoniebieski
Gęstość	0,72-0.78g/cm3

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Badana cecha	Metoda badania	EPBOARD0700HT
Tg/°C	ISO11357:2002(DSC)	≥150
Twardość (25 °C)	ISO 868:1985	≥72D
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	ISO11359-2:1999	≤49*10-6K-1
Moduł sprężystości przy zginaniu / MPa	ISO178:2001	≥1800
Wytrzymałość na zginanie / MPa	ISO178:2001	≥38
Wytrzymałość na ściskanie / MPa	ISO604:2002	≥53

*Warunki utwardzania: powyższe dane uzyskano po dotwardzaniu w 65 °C przez 7 h + 100 °C przez 1 h + 130 °C przez 1 h + 160 °C przez 8 h.

06-2026 EPBOARD 0700HT Strona 1 z 3

ZALECENIA OBRÓBKİ:

Klejenie płyt:

1. Przytnij, przygotuj i złóż bloki na sucho.
2. Przeszlifuj obie powierzchnie złącza papierem o gradacji 320.
3. Usuń pył sprężonym powietrzem, następnie oczyść powierzchnie klejenia odpowiednim rozpuszczalnikiem, np. acetonem.

4. Przed klejeniem pozwól odparować resztkom rozpuszczalnika.
5. Rozprowadź równomiernie około 600 g kleju epoksydowego na obu powierzchniach złącza za pomocą pacy zębatej.
6. Połącz obie powierzchnie z mokrym klejem i wywieraj równomierny nacisk, aż klej zacznie wypływać ze złącza. Usuń nadmiar i sprawdź, czy spoina ma równomierną grubość nieprzekraczającą 1 mm.
7. Przytrzymaj płyty lekkim dociskiem lub rozłożonym na całej górnej powierzchni stosu obciążeniem, aby zapewnić równomierny nacisk.
8. Przed dalszą obróbką zawsze zapewnij klejowi wystarczający czas utwardzania.
9. Aby uzyskać maksymalne właściwości cieplne systemu, zaleca się dotwardzanie. Część powinna stygnąć w autoklawie do temperatury pokojowej z szybkością nie większą niż 20 °C na godzinę. Zapobiega to szokowi cieplnemu płyty i kleju, który mógłby osłabić połączenie i wywołać pęknięcia naprężeniowe płyty.

Podparcie:

Płyta musi być odpowiednio podparta, aby uniknąć nadmiernych naprężeń od ciężaru własnego. Dla dużych modeli zaleca się stalową ramę wsporczą, która ogranicza ugięcia i ułatwia przenoszenie. Do mocowania konstrukcji wsporczej lub ramy do płyty używaj jednego z zalecanych klejów. Przy mechanicznym mocowaniu płyt wysokotemperaturowych zachowaj ostrożność: różnice współczynników rozszerzalności cieplnej mogą powodować wypaczenie lub mikropęknięcia podczas nagrzewania i chłodzenia.

DOSTĘPNE WYMIARY PŁYT

1500*500*50mm

1500*500*75mm

1500*500*100mm

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Pracuj w dobrze wentylowanym miejscu. Podczas obróbki unikaj kontaktu ze skórą i stosuj rękawice, maskę, okulary oraz odzież ochronną. Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki materiału.

06-2026 EPBOARD 0700HT Strona 2 z 3

UWAGA:

Powyższe dane uzyskano w określonych warunkach badań. Procedury i warunki rzeczywistego zastosowania mogą się różnić, dlatego przed użyciem zaleca się w razie potrzeby przeprowadzenie prób i potwierdzenie spełnienia rzeczywistych wymagań. EPTEK gwarantuje zgodność swoich produktów z własnymi najwyższymi zasadami zarządzania jakością.

06-2026 EPBOARD 0700HT Strona 3 z 3